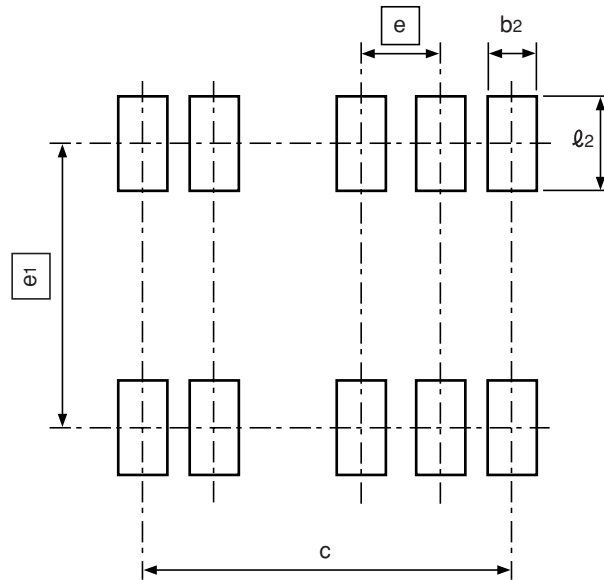


基板接続パッド推奨寸法



SSOP製品

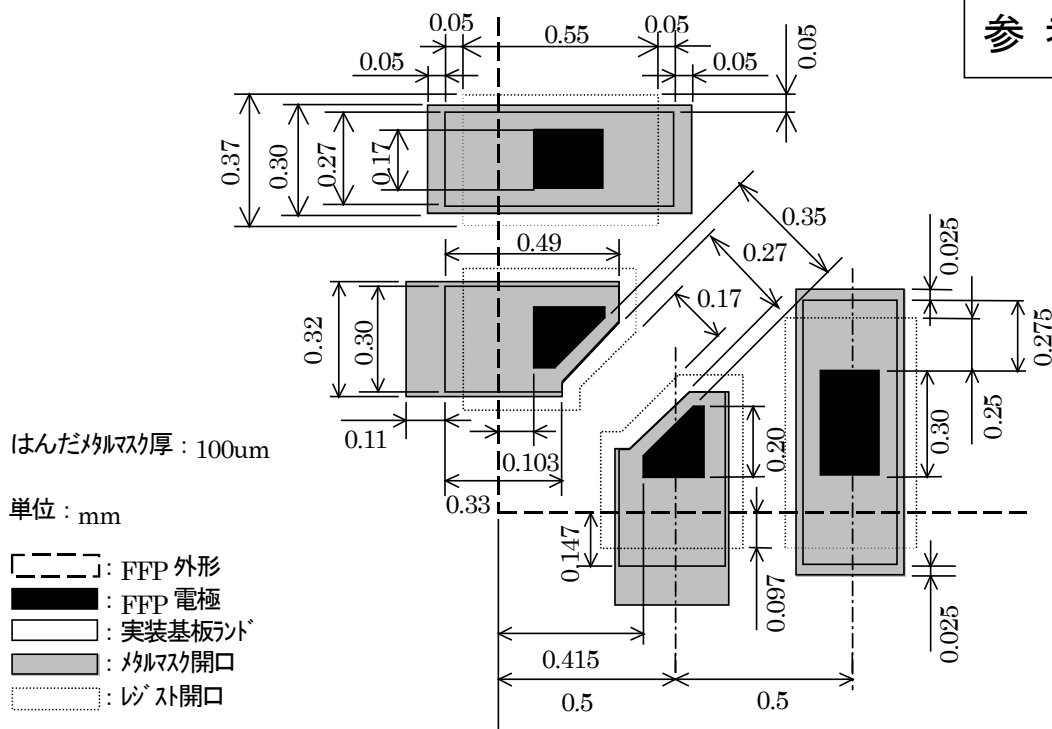
単位：mm

パッケージ	ピンピッチ	$b2$	$l2$	c	$e1$	e
8ピン SSOP	0.65mm	0.35	1.0	1.95	5.9	0.65
10ピン SSOP	0.5mm	0.3	1.0	2.0	5.9	0.5
10ピン SSOP-G, TSSOP-G	0.5mm	0.3	1.0	2.0	3.5	0.5
14ピン SSOP	0.65mm	0.35	1.0	3.90	5.9	0.65
16ピン SSOP	0.65mm	0.35	1.0	4.55	5.9	0.65

基板接続パッド推奨寸法

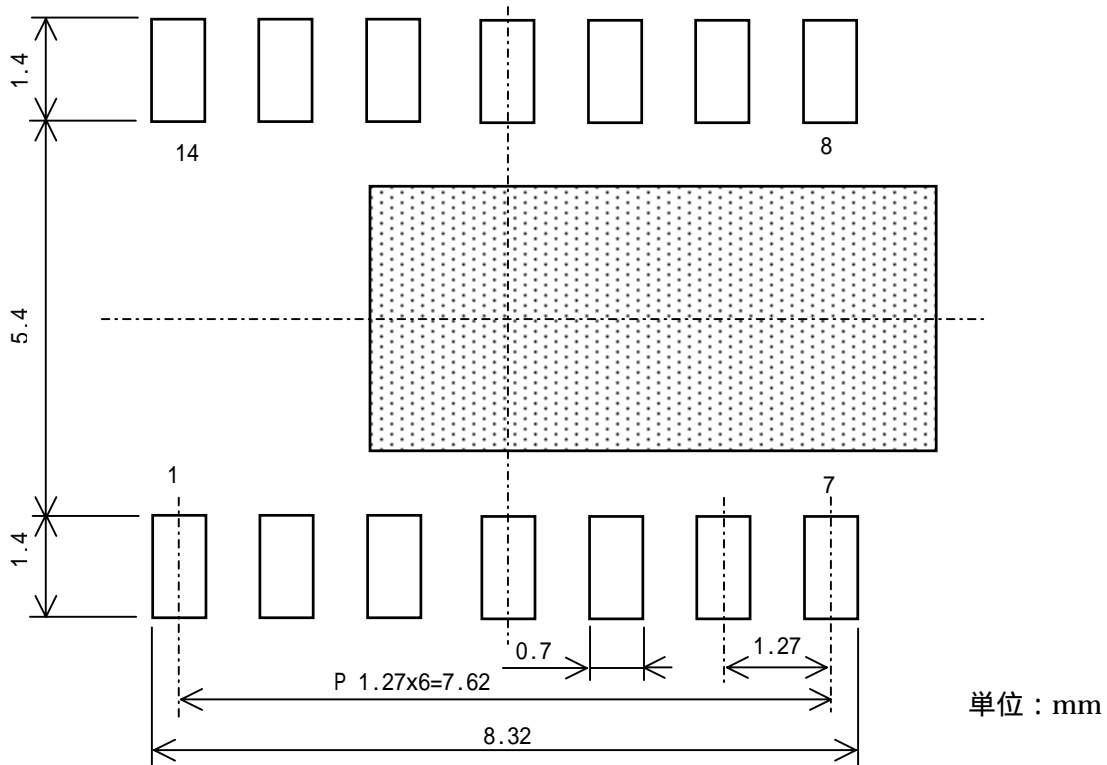
●FFP-12

参考

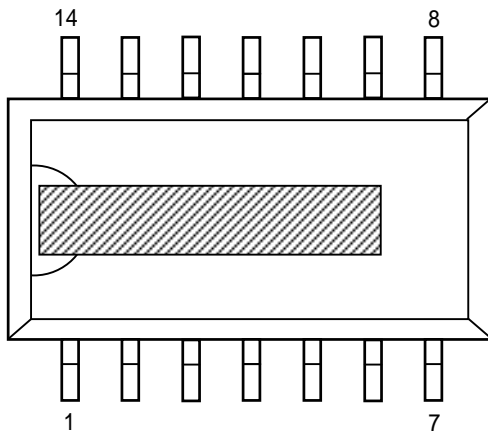




* 実装の容易性、半田ブリッジ発生率、接続の信頼性等を考慮して実装設計を行って下さい。

SOP-14 参考フットパターン

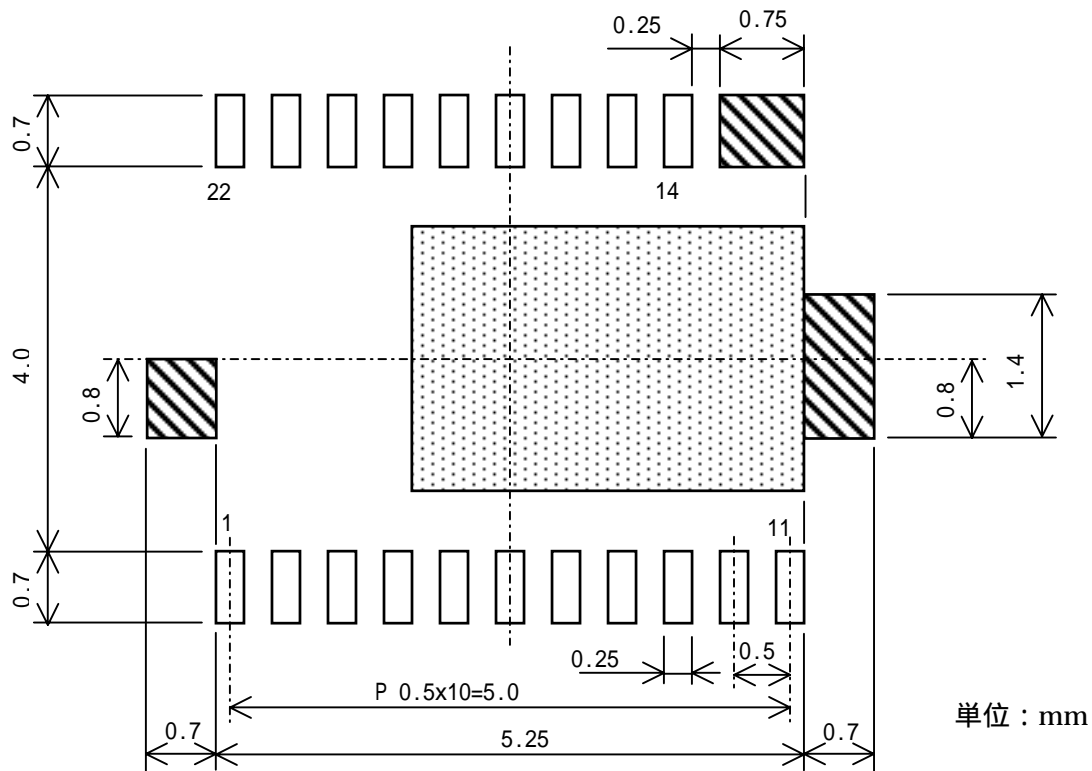


パッケージ上面図

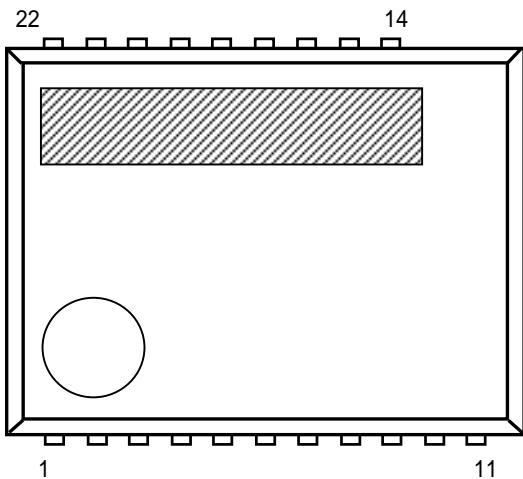


- 1、フットパターンの最適値は基板材料、半田ペースト材料、半田付け方法、装置精度などによって変わりますので、実際の設計に当たっては状況に合わせて適正化を計って下さい。
- 2、基板の製品実装部分の内  の付近は発振回路に近い為、ノイズによる誤動作を防ぐ意味で、他の信号線の配線には十分ご確認をいただけるようお願いいたします。
- 3、パッケージ上面の  部分に水晶振動子の金属ケースの一部が見えることがありますが製品の特性・信頼性に影響するものではありません。

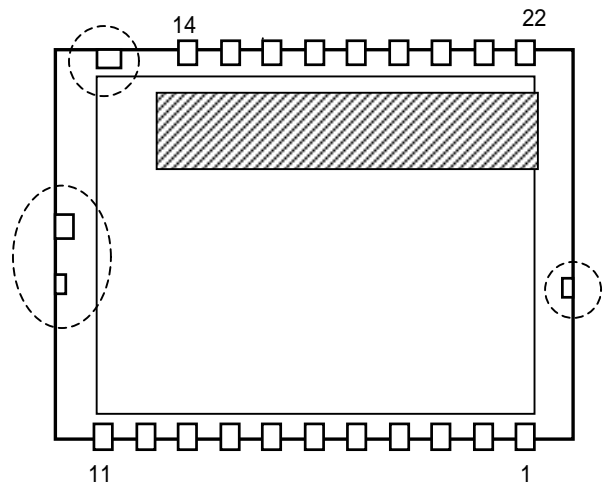
SON-22 参考フットパターン







パッケージ上面図



パッケージ下面図



- 1、フットパターンの最適値は基板材料、半田ペースト材料、半田付け方法、装置精度などによって変わりますので、実際の設計に当たっては状況に合わせて適正化を計って下さい。
- 2、フットパターンの斜線部分  の部品面には信号パターンをレイアウトしないで下さい。 で囲まれたタブ吊りリードや不要リードの切断痕とショートする可能性があります。
- 3、基板の製品実装部分の内  の付近は発振回路に近い為、ノイズによる誤動作を防ぐ意味で、他の信号線の配線には十分ご確認をいただけるようお願いいたします。
- 4、パッケージ表裏面の  部分に水晶振動子の金属ケースの一部が見えることがありますが製品の特性・信頼性に影響するものではありません。